Označení **wafer** se v mikroelektronice používá pro tenký plátek křemíku o průměru 6 až 12 palců (*initial wafer*), na kterém se poté technologickým postupem vytvoří aktivní elektronické součástky nebo integrované obvody (*finished wafer*). Po skončení technologického procesu se tento plátek zbrousí na tloušťku několika málo set mikrometrů, nalepí na tenkou adhezivní plastovou podložku a nařeže na jednotlivé čipy, které se následně zapouzdří.